



设备前端模块

搭载直驱伺服电机的洁净机械手、Aligner、直线导轨，实现高 Throughput。适应于 6"、8"、12" 晶圆。根据不同需求可搭配 SEMI 标准的 Foup、Fosb、Open Cassette、Smif Port 等装载单元，同时也可以实现装载单元的混搭配置。

AUTOMATIC WAFER TRANSFER SYSTEM



产品特点

- ▶ 通过选配2台Aligner可以达到高Throughput
- ▶ 真空吸附式取放片和边缘夹持式取放片（可选）
- ▶ 可兼容150/200/300mm Wafer
- ▶ OHT、Stocker可对应

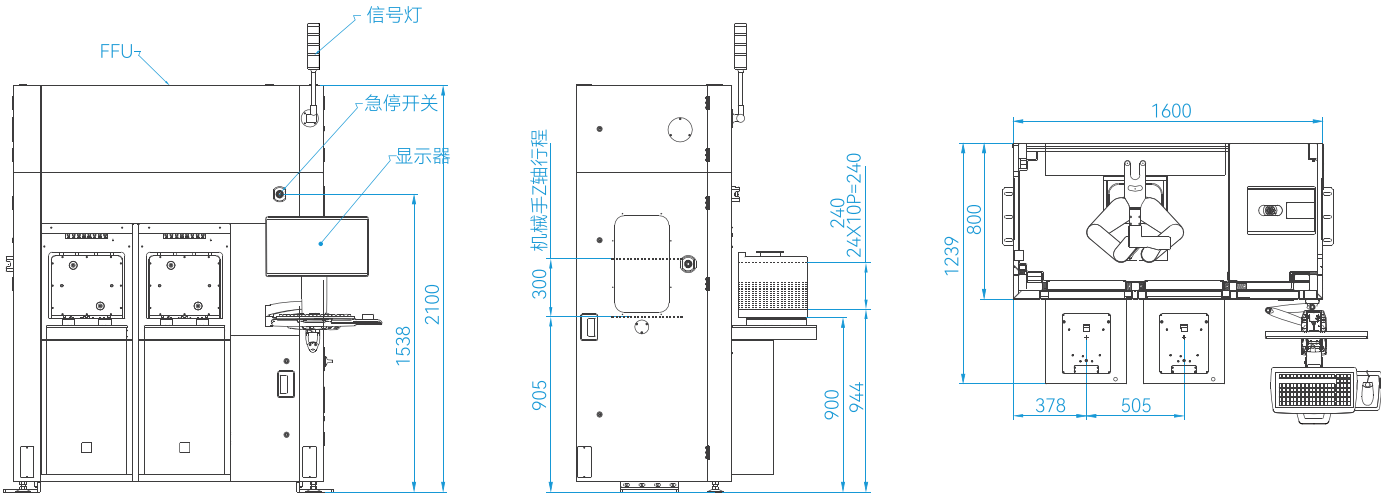
选配

- ▶ E84
- ▶ OCR
- ▶ Ionizer
- ▶ Autoteaching
- ▶ Teaching pendant
- ▶ Chemical Filter
- ▶ 可对应Barcode Reader、RF-ID Reader

规格参数（以适用 12" Wafer 的 EFEM 为例）

型号	VEM2200	VEM2300	VEM2400
Port数量	2	3	4
传送对象	300mm Wafer $\varnothing 300\pm 0.2\text{mm}$		
载体	300mm FOUP 25 段 (SEMI E47.1)		
	300mm FOSB 25 段 (SEMI E31)		
电源电源	单相 AC200V ~ AC220V $\pm 10\%$ 50/60Hz $\pm 5\%$		
电流	4kVA(20A/200VAC) 包含FFU		
真空（压力）	$-80\text{kPa} \sim -90\text{kPa}$		
真空（流量）	40L/min	50L/min	60L/min
正压（压力）	$0.6\text{MPa} \sim 0.7\text{MPa}$		
正压（流量）	20L/min	30L/min	40L/min

设备图纸



星微科技

详细规格参数内容请由此下载：
xivitech.com/downloads/



官网



公众号